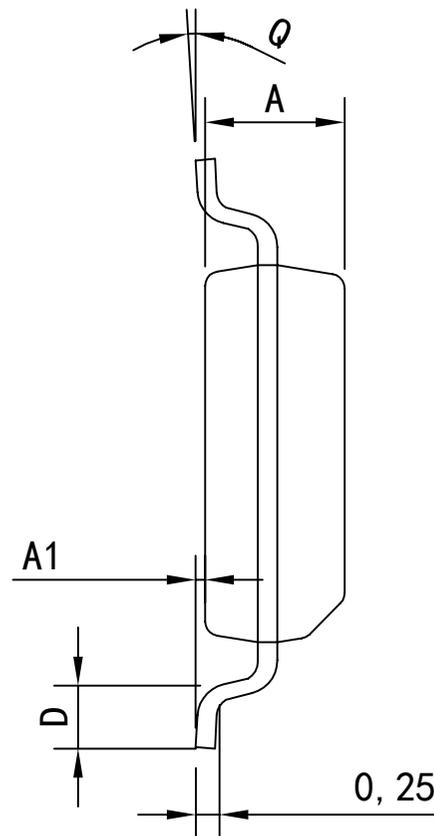
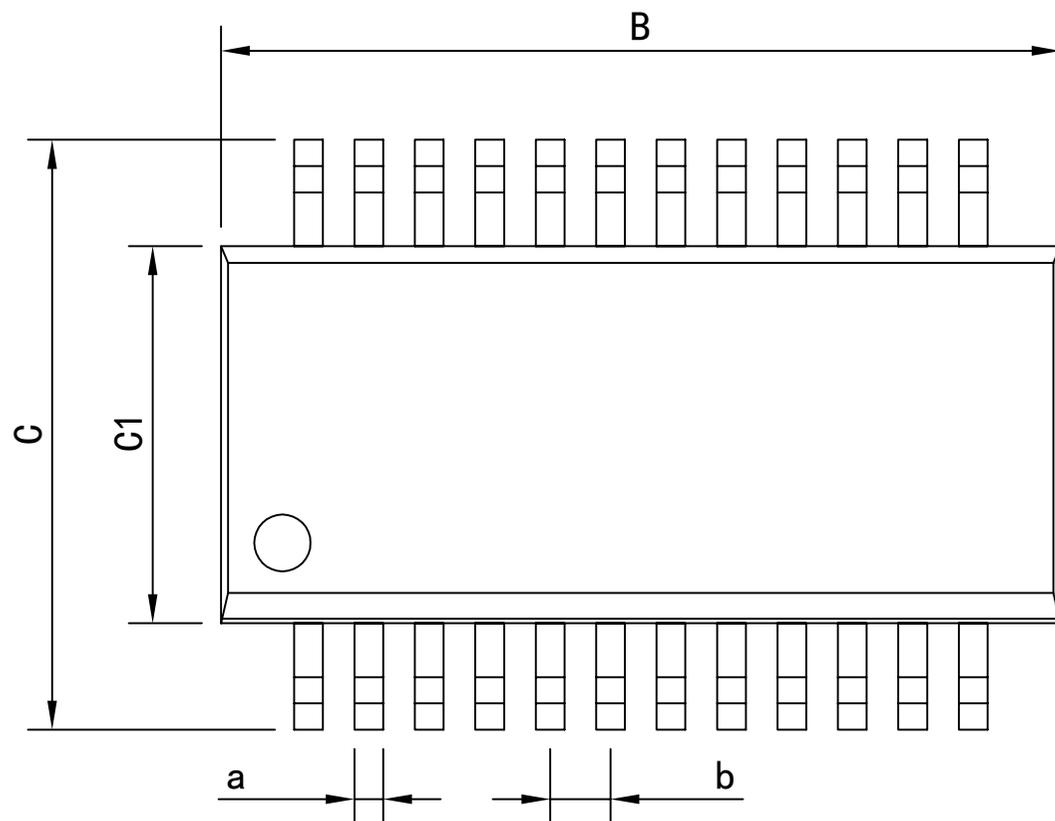




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SSOP-24

文件名称:
HG-SSOP24

文件编号:
HGWXT-230041

版本 V1.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-8-1

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT:mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.30	0.10	8.55	5.80	3.80	0.50	0°	0.23	0.635			
MAX	1.50	0.25	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.31	BSC			